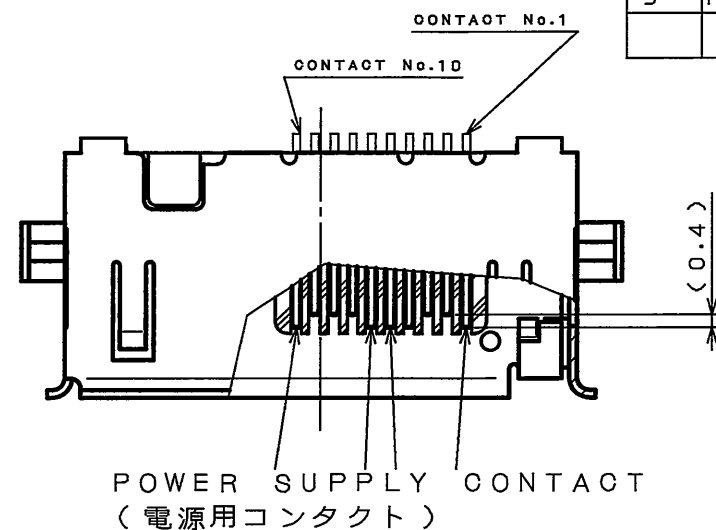
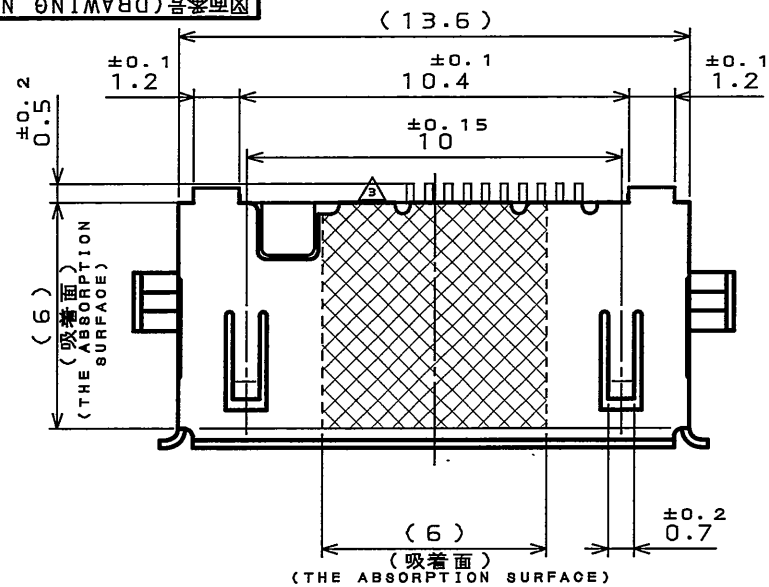


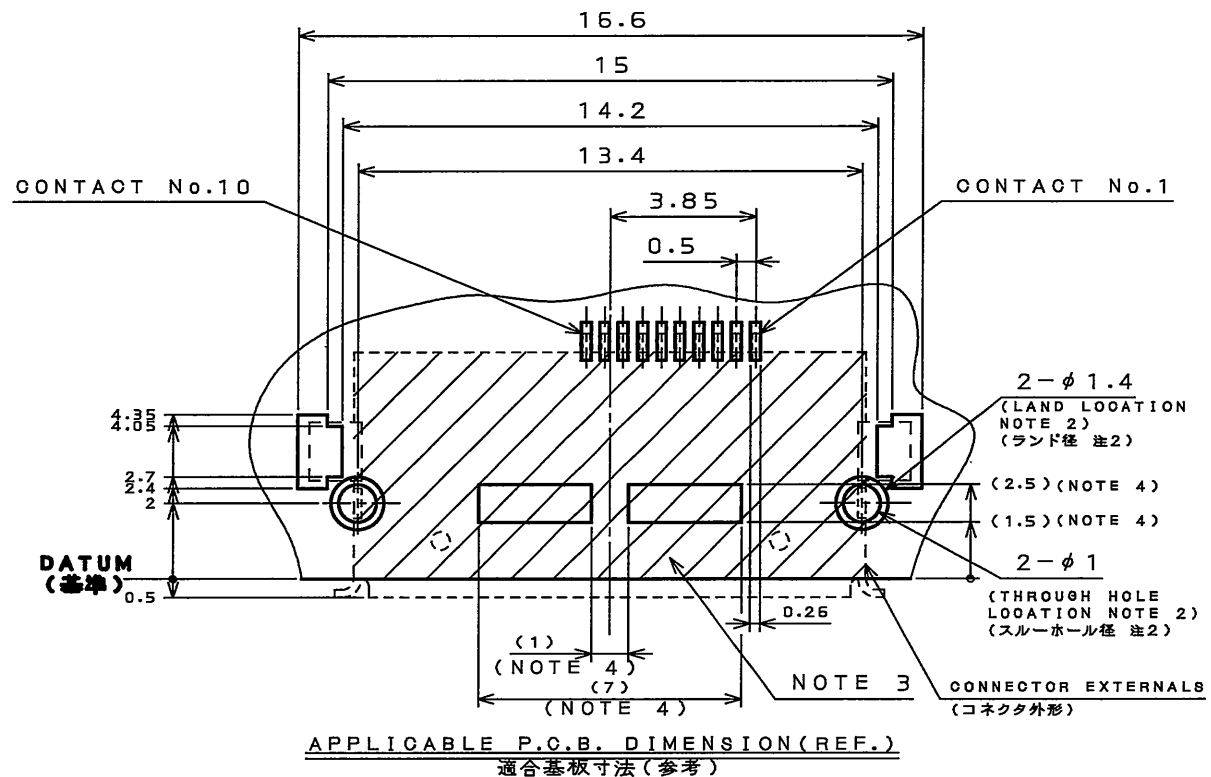
885001RS

(DRAWING NO.) 台線図

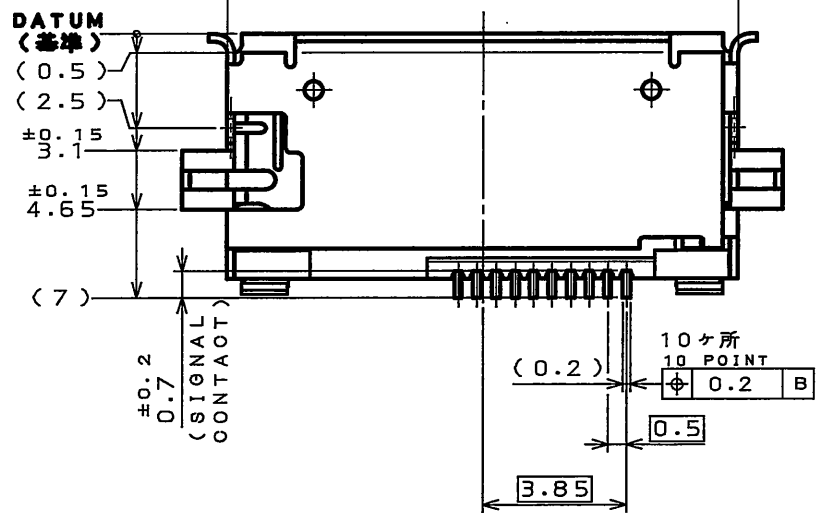
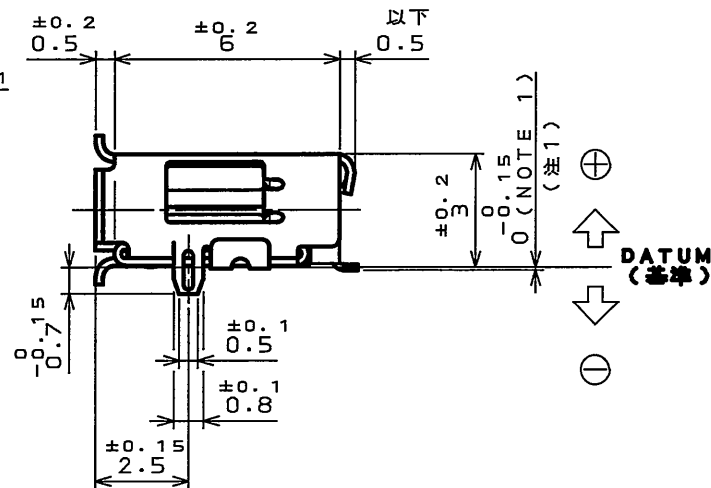
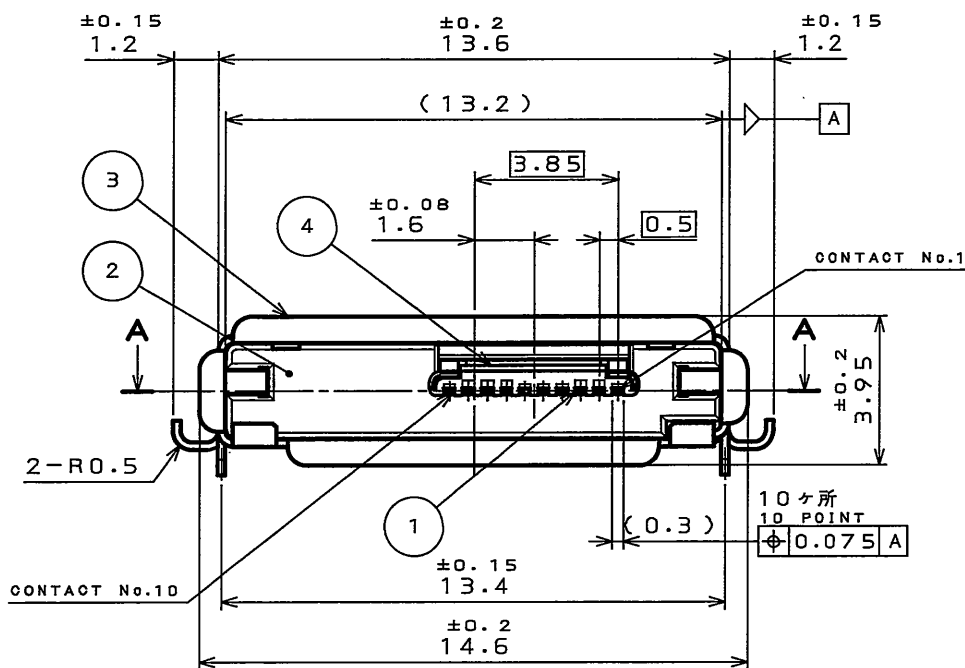
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 GHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1.Sep.2004	055726	ADDED DIMENSION		H.OOTANI		Y.KUBOTA
3	16.Jun.2006	060406	CHANGED FORM		H.OOTANI		<i>Y. Kubota</i>



SECT. A-A
 (SCALE 5:1)



NOTE 1. ⊕ AND ⊖ DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERANCE TERMINAL DIMENSION IS 0-0.15, AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
 2. LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
 3. PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.
 4. THIS DIMENSION IS UP OF STRENGTH TO SOLDERABILITY.
 注1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は "0-0.15" であり、公差内におけるバラつき (1コネクタ内のMAX値とMIN値の差) は0.1以下とする。
 2. ランドは基板の両側に設けること。また、スルーホールの穴はスルーホールメッキであること。
 3. 図に示す範囲 (斜線部 コネクタ下部) をパターン禁止領域とする。
 4. 適合基板寸法中のかっこ寸法はコネクタ半田付け強度UPを行なう際の参考寸法である。



符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	SIGNAL GUARD PLATE	1	STAINLESS STEEL		
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	(LEAD-FREE) TIN/TIN-ALLOY PLATING	
2	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	(BLACK)	UL94 V-0
1	SIGNAL CONTACT	10	ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL TERMINAL AREA: GOLD FLASH	GOLD PLATING: 0.1μm MIN GOLD FLASH PLATING: 0.03μm~0.1μm
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30012		第1版 (ORIGINAL DATE) 26.Jan.2004		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) RA1
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) RA1R010H1A	
寸法 (DIMENSION)		担当 GHK. T.OYAKE		製図 APPD.	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		承認 APPD. Y.KUBOTA	
. ±0.8		.X ±0.4		.XX ±0.1	
.XXX ±		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ100588	

DOF-0-212E(03.08)

